

鋁線打線機

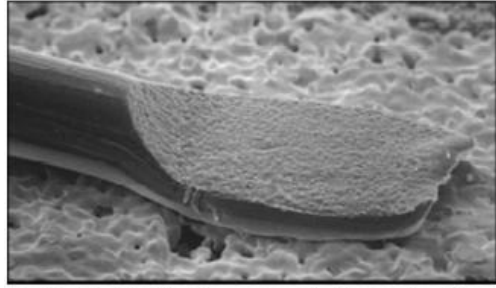
Wire Bonder

系統簡介:

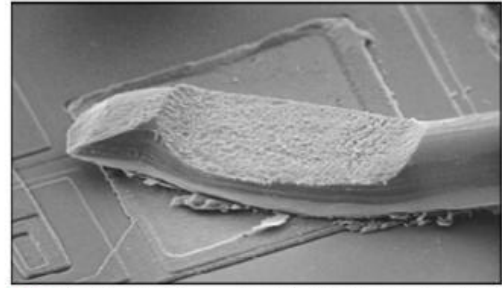
提供型號 SPB-U668 晶片鋁線打線服務

儀器圖片:

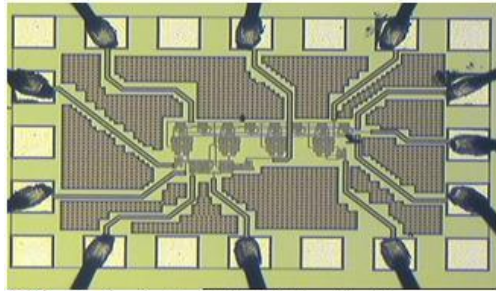




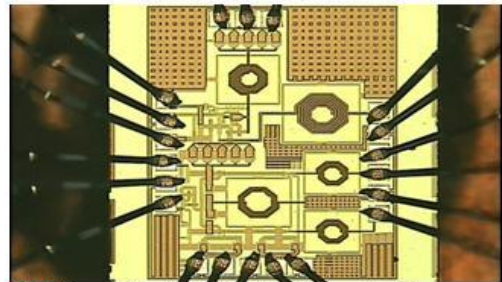
◎無過長線尾，較整齊之切面



✗有留線尾，較不整齊之切面



◎Pad大小約60*60無線尾



✗Pad大小約60*60有線尾

儀器規格型號:

1. 型號:SPB-U668
2. 新美化精機工廠股份有限公司
3. 適用線徑：鋁線 1mil/0.0254 mm~1.25mil/0.0317 mm
4. 鋁線直徑:30~40 μm
5. 鋼嘴壓扁大後大小 50~80 μm
6. 鋼嘴長度：L=828mil/21.03 mm
7. Bond Wire 最短可能打約 1~3mm,晶片 Pad 到包裝的 Lead 的距離和位置
通常是 2~5mm 長一點可以到 1~2cm 甚至更長,但需熟練的技術

8. 鋁線一條大約約可耐流 300-400mA ,金線約 500mA ,金線驗證至 1A 會變紅
已趨近最大值
9. 提供加熱盤與黏著劑 Epoxy(不導電)固定晶片
10. 工作半徑 : 150 mm
11. 顯微鏡 : 放大倍率 15x & 30x 兩檔變倍
12. 使用電源 : 110V/60HZ or 220V/50HZ
13. 外型尺寸 : 61(深)x57(寬)x60(高)cm

服務項目:

1. 操作鋁線晶片打線服務

注意事項:

若為第一次使用,請與負責人電話連繫使用細節.

儀器維護者:

張小姐 03-5773693#7192 henzu@narlabs.org.tw